

石巻第一工場 技術ロードマップ

Ishinomaki Factory No.1 Technology Roadmap

項目			FY2025	FY2026	FY2027
L/S	Subtractive	HVM	40/40	40/40	←
		Proto Type	35/35	35/35	←
	MSAP	HVM	30/30	25/25	←
		Proto Type	25/25	20/20	←
Thickness (Core)	HVM	60	60	←	
	Proto Type	50	50	←	
Thickness (Prepreg)	HVM	30 (#1027)	25 (#1017)	←	
	Proto Type	25 (#1017)	20 (#1010)	←	
LVH/Land Dia. (Laser)	HVM	φ75/φ150 (PP<40)	φ75/φ150 (PP<40)	←	
	Proto Type	φ60/φ125 (PP<30)	φ60/φ125 (PP<30)	←	
BVH/Land Dia. (Drill)	HVM	φ150/φ250	φ125/φ225	←	
	Proto Type	φ125/φ225	φ105/φ200	←	
TH/Land Dia. (Drill)	HVM	φ200/φ450	φ200/φ450	←	
	Proto Type	φ200/φ400 (APR<6.4)	φ200/φ400 (APR<6.4)	←	
Layer	HVM	2~12L (MLB, HDI, AnyLayer)	2~12L (MLB, HDI, AnyLayer)	←	
	Proto Type	14L (MLB, HDI)	14L (MLB, HDI)	←	
Surface Treatment (OutSource)			OSP, 電解Ni/Au, 無電解Ni/厚付けAu, 無電解Ni/Pd/Au		

Fine MSAPプロセス

L/S	20/20μm	30/30μm	50/50μm
表面写真			
断面写真			
仕上がり値	21/18	30/30	49/51



パターンめっき



フラッシュエッチング



LDI



レーザー加工機

	FY24	FY25	FY26	FY27	FY28
L/S	35/35	30/30	25/25	20/20	
Via/Land	φ80/φ150μm~φ60/φ125μm			φ50/φ115μm	

SR薄板対応

現行機



新規印刷機



対応可能板厚 (Cu含まず)

現行機
0.20~1.60mmt

新規印刷機
0.06~1.60mmt

印刷テーブルの吸着用バキュームポンプ仕様変更により
薄板基板対応が可能